

## 9. PCB-Designer-Tag

### 5G - 3x High

### Cutting-Edge Design: HDI, High Speed, High Power

Termin:	28.05.2019
Ort:	WITTENSTEIN SE Walter-Wittenstein-Straße 1 97999 Igersheim - Harthausen
08:30 – 09:00 Uhr	<b>Registrierung</b>
09:00 – 09:10 Uhr	<b>Begrüßung</b> Thomas Bayer, Leiter Innovation Lab, WITTENSTEIN SE Prof. Dr. Rainer Thüringer, FED-Vorstandsvorsitzender
09:10 – 09:55 Uhr	<b>Technology evolution towards 5G</b> Referent: Thomas Randt, Telit
09:55 – 10:30 Uhr	<b>Kaffeepause &amp; Networking</b>
10:30 – 11:00 Uhr	<b>Smarte Produkte, Data Driven Services und Industrial Intelligence</b> Referent: Bernd Vojanec, WITTENSTEIN SE
11:00 – 12:00 Uhr	<b>1. Workshop – High-Density-Interconnect und High-Speed</b> Einführungsvortrag zu HDI & High-Speed (30 Minuten) Workshop zu Layout-Lösungen für die kompakten und komplexen Baugruppen von heute und morgen (30 Minuten) Referent: Michael Schwitzer, Ciboard electronic GmbH



- 12:00 – 13:15 Uhr      **Mittagspause & Networking**
- 13:15 – 14:15 Uhr      **2. Workshop – High-Power-Baugruppen-Design**  
Einführungsvortrag zu High Power (30 Minuten)  
Workshop zu High-Power-Umsetzung auf der Leiterplatte (30 Minuten)  
Referent: Michael Schleicher, SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
- 14:15 – 14:45 Uhr      **Kaffeepause & Networking**
- 14:45 – 16:15 Uhr      **Firmenrundgang bei WITTENSTEIN SE**  
Innovationsfabrik und Teile der Produktion
- 16:15 – 16:30 Uhr      **Abschlussrunde/ Verabschiedung**
- 16:30 Uhr                **Ende der Veranstaltung**

**Moderation der Workshops: Prof. Dr. Rainer Thüringer, FED**